



#1 Coating Technology in The World Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

強い粘着力による、信頼ある薄膜固定テープ

分子勾配膜®両面テープ

200Y シリーズ

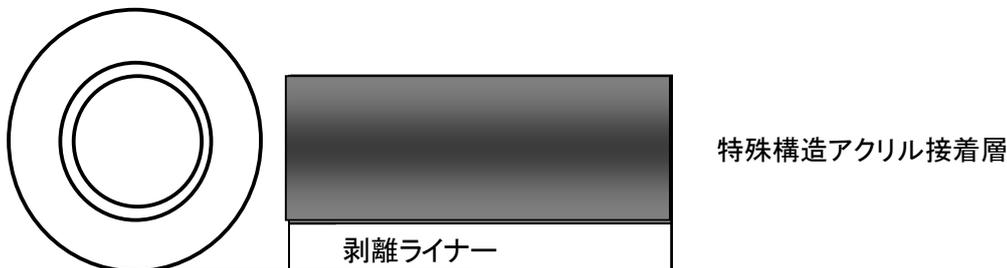
特徴

- ①薄くて耐熱性の高い接着シート
- ②所定の温度を超えると接着剤と同様の性能発揮
150°C以上で接着向上
- ③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
- ④常温では初期粘着力があり、通常の粘着テープと同様に使用できる
- ⑤屈曲特性、耐衝撃性に優れます

用途

FPC補強板
ICカードの貼り合せ
面状発熱体の固定
放熱材の固定

構造



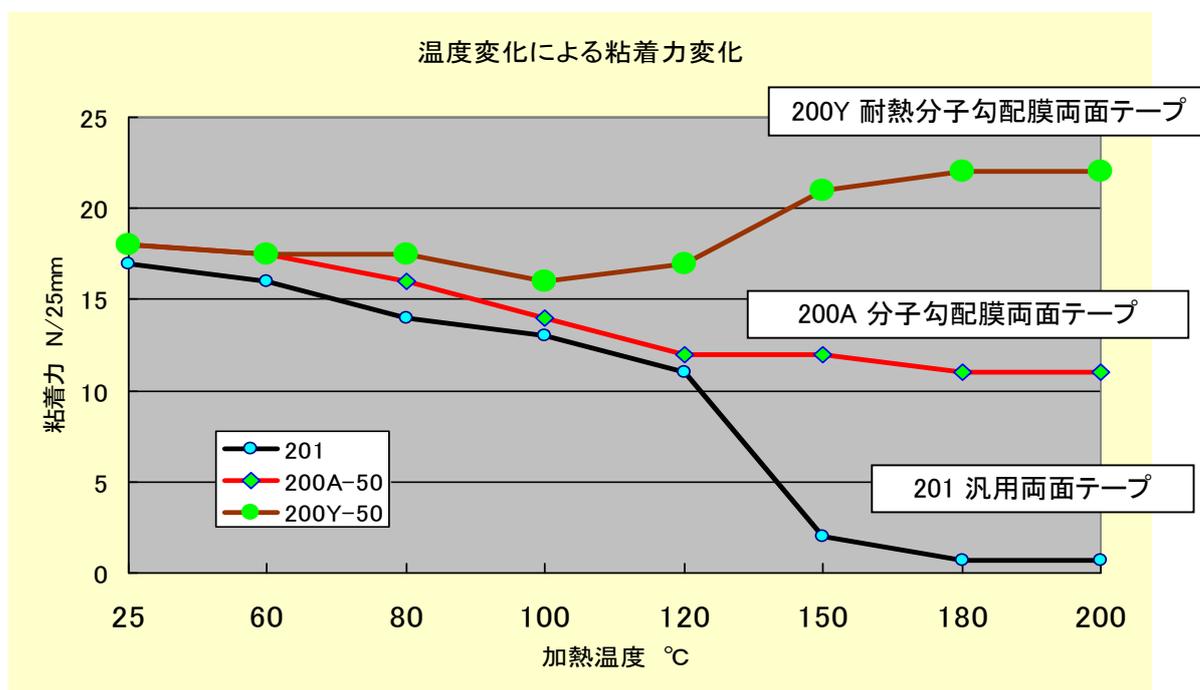
特性

1. 標準特性

製品名	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	加熱圧着後粘着力 (N/25mm)
200Y30	0.03	7	15
200Y50	0.05	10	22

裏打ち材 PET25 μ m
引張速度 300mm/min
引張角度 180度
測定温度 23°C
貼り合わせた後、24時間後の測定値

2. 加熱後の粘着力



圧着条件 加圧時間 30秒

3. 耐電圧特性(絶縁耐力)

表1 絶縁耐力試験結果 (遮断電流 0.5 mA の条件、n=3)

試験電圧	200Y30	200Y50
AC 200 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 400 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 600 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 800 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 1 000 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 1 500 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 2 000 V	10 秒 OK	10 秒 OK
AC 2 500 V	NG	10 秒 OK
AC 3 000 V	NG	NG

200Y30

2KV/0.03mm

=66KV/mm

200Y50

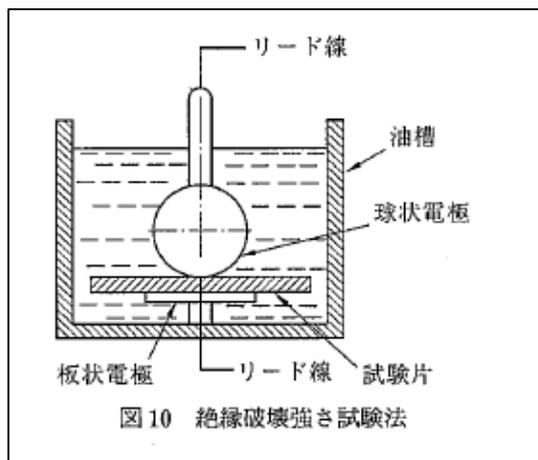
2.5KV/0.05mm

=50KV/mm

耐電圧試験方法・手順

所定の印加時間で試験板に通電し、
絶縁破壊をする電圧測定
JIS C2110 準拠

- ①板状電極に試験片を貼る
- ②球状電極(25mmφ)を
試験体にあて、電圧印加。
- ③絶縁破壊による
通電が生じなければ、更に電圧を上げる。
- ④絶縁破壊による通電が生じた段階で、試験終了。



ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- Bシリーズ(黒色タイプ)は、遮光補助用です。遮光性を保証するものではありません。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

2011年8月23日 発行